

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2026-011

奥士康科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 317,360,504 股剔除回购专用证券账户持有的 2,888,300 股后的 314,472,204 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥士康	股票代码	002913
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尹云云	韩裕龙、李家娜	
办公地址	广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 32 楼	广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 32 楼	
传真	-	-	
电话	0755-26910253	0755-26910253	
电子信箱	zhengquanbu@askpcb.com	zhengquanbu@askpcb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司从事的主要业务

公司专业从事高精度印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，主要产品包括单面板、双面板及多层板等，广泛应用于数据中心及服务器、汽车电子、通信及消费电子等领域，并积极拓展能源电力、工业控制及医疗电子等市场。围绕

高性能、高可靠性发展方向，公司依托二十多年的技术积累与制造经验，在高层数、高频高速及高可靠性 PCB 等领域形成较强技术能力，具备从研发支持到规模化生产的综合制造体系。公司不断提升产品质量与交付稳定性，已积累一批行业优质客户资源，综合竞争实力持续增强。

在数据中心及服务器领域，公司紧跟 AI 算力及云计算快速发展的趋势，围绕高性能计算场景对 PCB 在高速信号传输、层数结构设计、材料性能及可靠性方面的高端要求，持续提升高层数及高频高速 PCB 产品研发能力。相关产品已应用于 AI 服务器及高性能服务器平台，相关业务持续推进，公司在该领域的技术能力和客户粘性不断增强。

在 AIPC 领域，公司与多家主流 PC 厂商建立合作关系，围绕高算力平台对 PCB 在高速互联、高集成度及散热性能等方面的技术需求进行产品开发并实现稳定供货。随着 AI 终端渗透率提升，公司持续推进 AIPC 相关业务布局，聚焦重点客户及应用场景，不断完善产品体系。

在汽车电子领域，公司顺应汽车电动化、智能化发展趋势，重点布局自动驾驶、智能座舱及新能源控制系统等应用方向。汽车电子产品对安全性、稳定性及环境适应性要求较高，公司具备高可靠性工艺控制及产品一致性管理能力，相关产品已进入多家国际知名汽车品牌及 Tier1 供应商体系，实现配套供货。

公司为中国电子电路行业协会（CPCA）副理事长单位，连续多年入选 CPCA 内资 PCB 百强企业、中国电子电路行业百强企业，并连续入选 PrismaMark 发布的全球 PCB 企业百强名单，在行业内具有较强影响力，综合实力处于行业前列。公司是国家高新技术企业，并荣获国家企业技术中心、湖南省印制电路板工程研究中心、国家知识产权优势企业等一系列荣誉资质。未来，公司将继续围绕高端应用领域加大技术创新力度，优化产品结构与客户结构，提升规模化制造能力与精细化管理水平，增强持续盈利能力和综合竞争实力。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）全球印制电路板（PCB）市场规模及增长趋势

在人工智能、数据中心、高速网络等 PCB 下游应用领域持续推动下，全球 PCB 需求总体呈增长态势。根据 PrismaMark 统计，2025 年全球 PCB 产值为 848.91 亿美元，同比增长 15.4%。其中，2025 年中国大陆 PCB 产值为 484.59 亿美元，2029 年 PCB 市场规模预计将达 624.63 亿美元，2024—2029 年年均复合增长率预计为 8.7%。在人工智能算力基础设施扩张、智能终端升级及新能源汽车渗透率持续提升背景下，行业进入新一轮增长周期。

根据 PrismaMark 预测，2029 年全球 PCB 市场规模预计将达 1,092.58 亿美元，2024—2029 年年均复合增长率预计为 8.2%。预计全球 PCB 行业仍将保持增长态势，增长动能主要来自 AI 服务器、高端多层板及 HDI 产品需求提升。

从产品结构来看，随着终端产品向高性能、高密度方向发展，PCB 产品结构持续升级。根据 PrismaMark 数据，2025 年，全球 HDI 产值为 157.17 亿美元，同比增长 25.6%；全球多层板产值为 330.91 亿美元，同比增长 18.2%。在人工智能服务器及高速网络需求带动下，HDI 板、高层数多层板及封装基板等高端产品占比持续提升，行业逐步向高层数、高频高速及高可靠性方向发展。

（二）下游市场空间广阔，细分应用领域发展迅速

印制电路板（PCB）作为电子元器件领域的关键基础部件，其下游应用领域极为广泛，涵盖服务器、通信、消费电子、汽车电子、工业控制等多个重要行业板块。PCB 行业的发展与下游各应用领域的发展态势紧密相连、相互影响，下游市场需求的变化直接影响 PCB 行业的市场规模、技术发展方向以及产品结构的调整。

1、服务器及 AI 算力基础设施

人工智能训练与推理需求持续增长，带动 AI 服务器市场规模扩大，在服务器行业中的占比持续提升。随着大模型与高性能计算需求快速发展，AI 服务器多采用异构架构，对算力密度和数据传输能力提出更高要求。PCB 在层数、面积、

材料性能及信号完整性等方面要求显著提升，推动材料向低损耗、极低损耗升级，同时带动高层数板及高端多层板需求持续增长。

AI 服务器相关 PCB 市场保持较快增长。根据 Prismark 数据，2024—2029 年 AI 服务器相关 PCB 市场年均复合增长率预计为 18.7%；其中，AI 服务器相关 HDI 的年均复合增速为 29.6%，AI 相关 18 层及以上多层板年均复合增长率为 33.8%，整体增速高于行业平均水平。

2、AIPC 市场

2025 年，随着人工智能应用向终端侧持续延伸，算力本地化趋势逐步增强，AIPC 成为推动 PC 产业升级的重要方向。相较传统 PC，AIPC 通过集成专用 AI 芯片与混合算力架构，在本地实现模型推理与数据处理，对高速信号传输、高密度互连及散热性能提出更高要求，推动 PCB 在层数、材料性能及工艺水平等方面持续升级，高端产品占比不断提升。

根据 Gartner 数据，2025 年全球 AIPC 出货量预计约为 7,780 万台，占 PC 市场比重约 31%；预计到 2026 年出货量将达到 1.43 亿台，占比提升至 55%，并有望在未来逐步成为 PC 市场主流形态。随着 AIPC 渗透率持续提升，其对高性能 PCB 的需求将同步增长，尤其是在高多层板及高速 PCB 等产品领域，对信号完整性、传输速率及可靠性的要求进一步提高，带动相关产品需求持续扩大。

3、汽车电子

在全球汽车产业向电动化、智能化转型背景下，汽车电子市场规模持续扩大。随着新能源汽车渗透率提升，汽车电子化程度显著提高，带动 PCB 单车价值量持续提升。

随着自动驾驶域控制器、多传感器融合系统及智能座舱等应用加速落地，对高频高速及高可靠性 PCB 的需求不断提升，推动车用 PCB 市场稳步增长。根据 Prismark 数据，2025 年全球车用 PCB 市场规模约为 97.12 亿美元，预计到 2029 年将达到 113.65 亿美元，年均复合增长率为 4.3%。

中国新能源汽车市场规模持续扩大。根据中国汽车工业协会数据，2025 年新能源汽车产销分别完成 1,662.6 万辆和 1,649 万辆，同比分别增长 29%和 28.2%，连续 11 年位居全球第一，为车用 PCB 行业提供了广阔的应用空间。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	9,115,919,565.35	8,044,545,444.52	13.32%	7,356,086,010.07
归属于上市公司股东的净资产	4,442,425,724.61	4,378,479,838.88	1.46%	4,107,620,059.43
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	5,529,601,554.15	4,565,930,085.34	21.11%	4,329,869,947.46
归属于上市公司股东的净利润	307,907,364.95	353,281,764.91	-12.84%	518,626,014.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	307,797,581.69	339,550,080.40	-9.35%	498,750,488.51

经营活动产生的现金流量净额	258,323,915.81	850,111,447.56	-69.61%	922,927,276.34
基本每股收益（元/股）	0.97	1.11	-12.61%	1.63
稀释每股收益（元/股）	0.97	1.11	-12.61%	1.63
加权平均净资产收益率	7.00%	8.36%	-1.36%	12.87%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,163,974,084.85	1,400,572,263.43	1,467,138,855.41	1,497,916,350.46
归属于上市公司股东的净利润	112,276,073.26	83,573,690.44	86,601,638.09	25,455,963.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,632,797.06	76,146,573.48	86,238,531.05	37,779,680.10
经营活动产生的现金流量净额	97,138,021.91	93,048,824.14	-4,793,788.63	72,930,858.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,868	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,300	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市北电投资有限公司	境内非国有法人	50.42%	160,000,000	0	不适用	0	
贺波	境内自然人	13.23%	42,000,000	0	质押	13,390,000	
程涌	境内自然人	4.73%	15,000,000	15,000,000	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.76%	11,920,336	0	不适用	0	
财达证券股份有限公司	国有法人	1.39%	4,421,300	0	不适用	0	

公司						
徐文静	境内自然人	1.36%	4,329,300	0	质押	2,500,000
邓振敬	境内自然人	1.08%	3,440,500	0	不适用	0
张文方	境内自然人	1.04%	3,289,590	0	不适用	0
邓振东	境内自然人	0.44%	1,402,800	0	不适用	0
刘道辉	境内自然人	0.41%	1,288,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东程涌先生与股东贺波女士为夫妻关系；股东深圳市北电投资有限公司为程涌先生、贺波女士及程嵩岐先生共同持股的企业，属于一致行动人。 2、除上述关系外，公司未知前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东邓振敬通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,440,500 股，共持有公司股票 3,440,500 股；公司股东张文方通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,268,190 股，共持有公司股票 3,289,590 股；公司股东邓振东通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,402,800 股，共持有公司股票 1,402,800 股；公司股东刘道辉通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,288,000 股，共持有公司股票 1,288,000 股。					

注：截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 2,888,300 股，比例为 0.91%。公司回购专用证券账户为公司报告期末前 10 名股东，但不纳入前 10 名股东列示。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

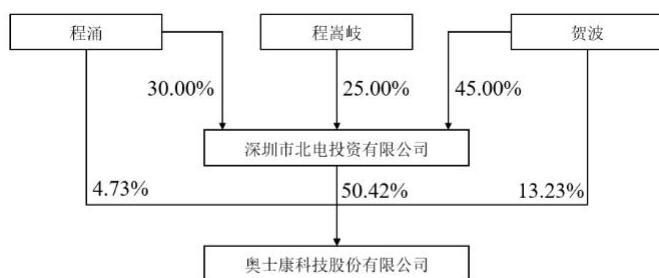
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

不适用。